

資金調達に関する補足説明資料

2024年2月20日

A I メカテック株式会社

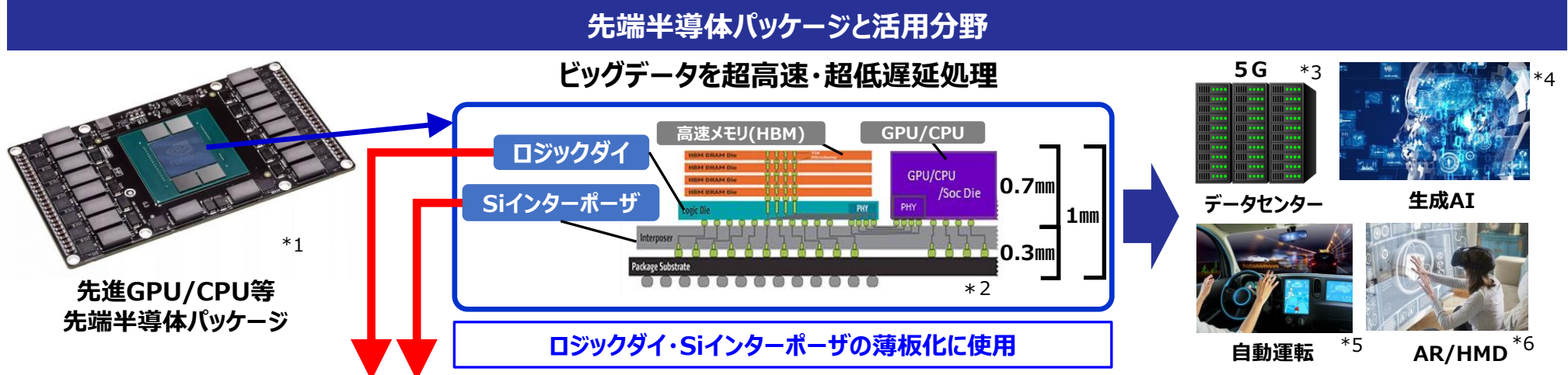
先進・革新技術で未来を創造

1. 成長戦略

先端半導体(生成AI半導体)向け：ウェハハンドリングシステム

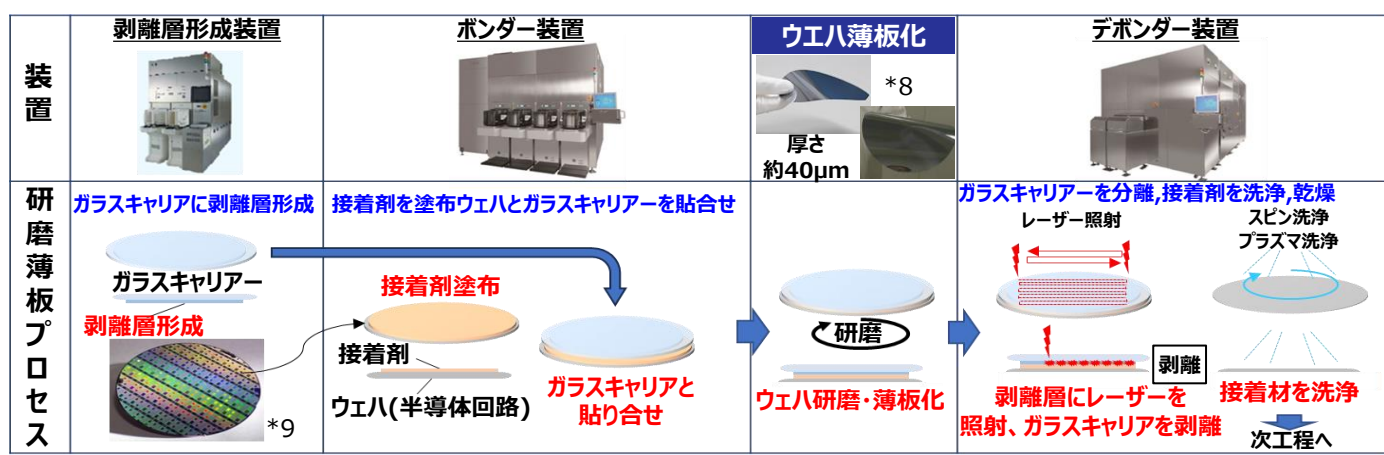
TOK(材料) + AIメカ(モノ作り力) + プロセスを一括提案し受注を拡大

■ 先端半導体パッケージにおける3次元化等により高さを抑えるためのウェハの薄板化が必須となり需要が拡大

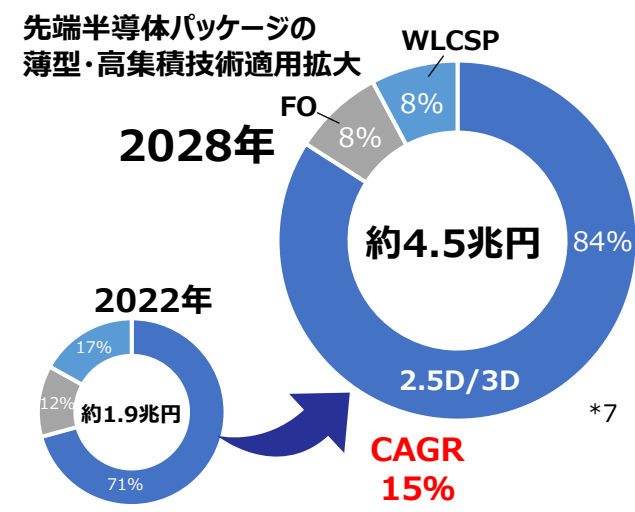


ウェハハンドリングシステム

(ガラスキャリアとウェハの貼付⇒薄板化、研磨工程へ供給⇒剥離・洗浄・乾燥)



予想市場規模

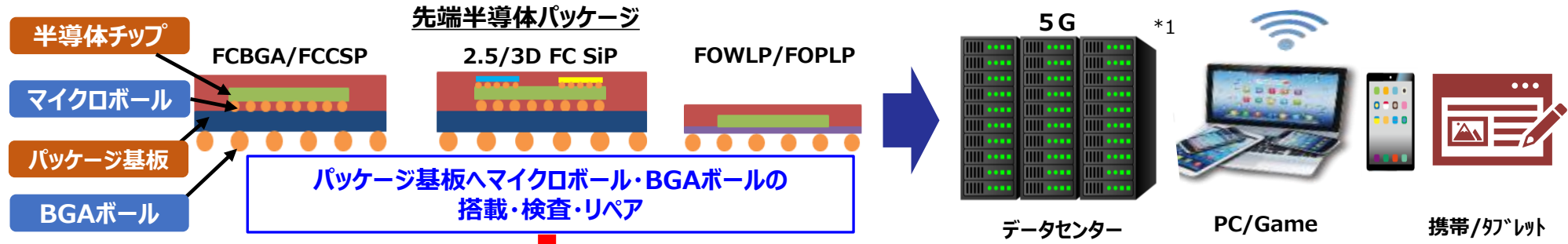


出所：*1 bto-mania.com *2 AMD *3 DESIGNALIKIE, Limited. *4 NTT西日本 *5株式会社オールパウト *6 KDDI *7 Yole *8 株式会社ワカテック *9 EDN Japan

新製品の投入により受注を拡大

- 現在のAIメカテックの主戦場は高密度化が求められる先進パッケージ市場 ⇒ 受注実績拡大中
- JUKIとのコラボレーションにより顧客の多様なニーズに合わせたコストパフォーマンスに優れた新製品を追加投入

半導体パッケージと活用分野



先端半導体パッケージボール搭載システム

予想市場規模

ボール搭載システム (ABM-Gシリーズ) **新製品** ボール搭載システム (ABM-Nシリーズ)

基板用ライン ウェハ用ライン

・設置面積1/2 (当社比)

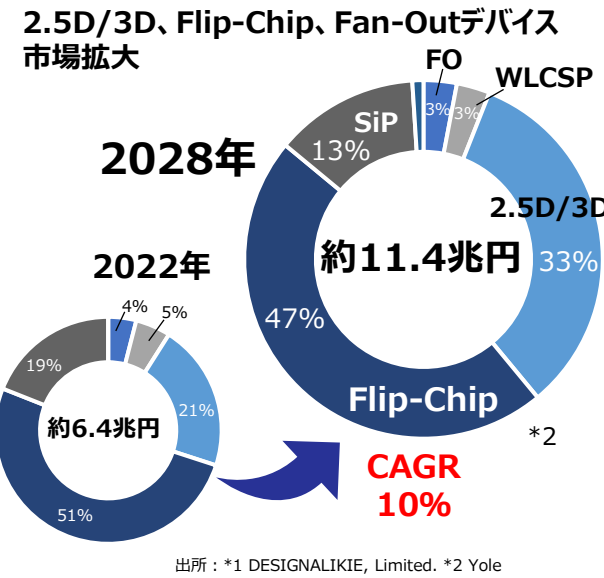
先進半導体パッケージ市場

電極Bumpサイズ(μm)	はんだボールサイズ
BGA Bump (350~500μm)	μBGA Bump (200~400μm)
500 400	300 200
	μBump(C4) (40~150μm)
	100 50 25 15



はんだボール搭載例

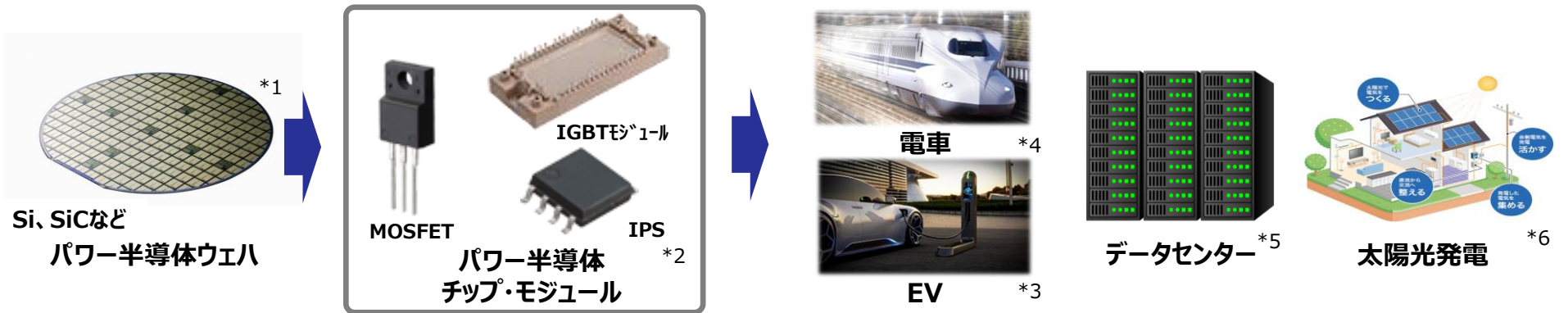
Ball径：Φ30μm



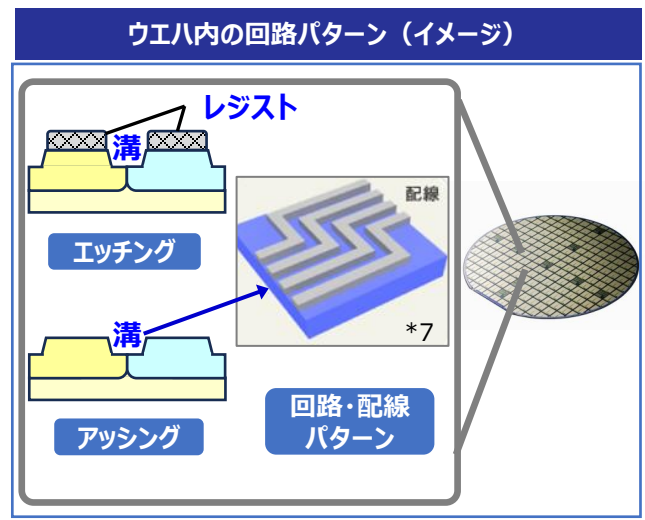
TOK(材料) + AIメカ(モノづくり) + プロセスを一括提案し受注を拡大

EV、データセンター等の効率向上、小型化に必要な「高効率」「低抵抗」「高耐電圧」のパワーデバイス製造に貢献

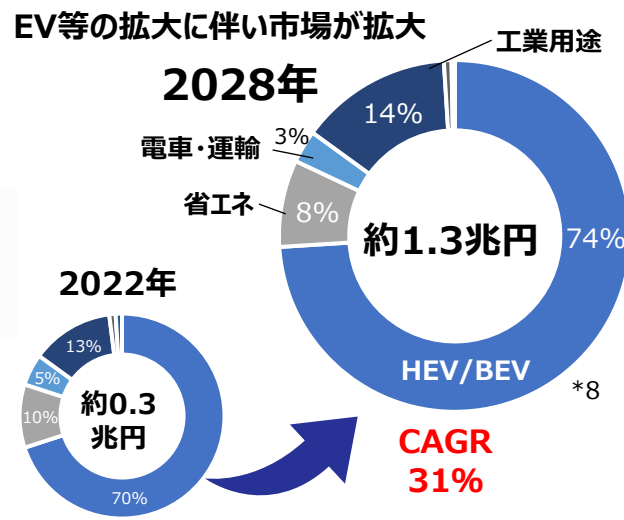
パワー半導体と活用分野



パワー半導体用プラズマエッチング/アッシング装置、UV装置



予想市場規模

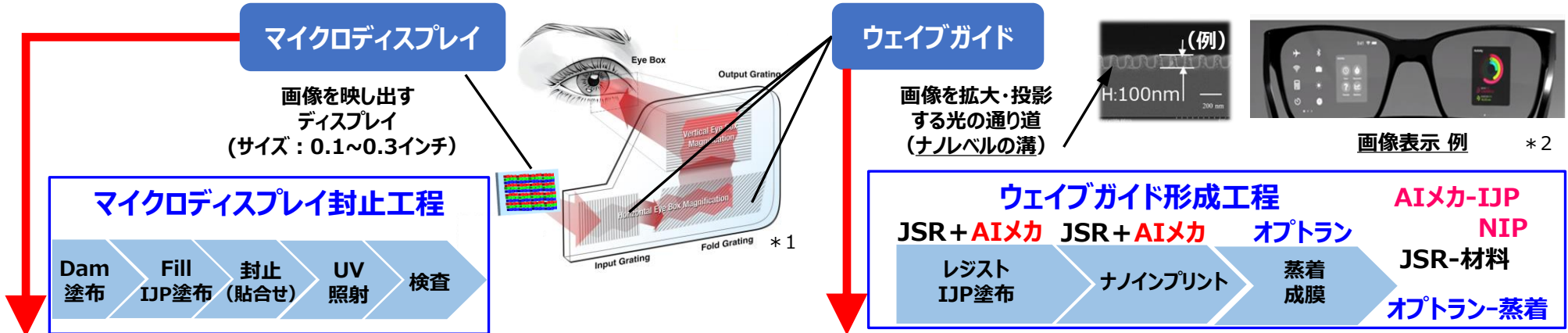


出所：*1 Response HP *2 富士電機HP *3 myroad.izumi-zenkou.com*4 www.itmedia.co.jp*5 DESIGNALIKIE, Limited. *6 株式会社日本エコシステム *7 NEDO HP *8 Yole

JV：ナノリソテックス(AIメカ+オプトラン+JSR)での3社連合によるプロセス含め一括提案

- メタバース用スマートグラス向けマイクロディスプレイ一括封止ラインの受注実績、引合い拡大中
- JV：ナノリソテックスにおいて、ウェーブガイド形成ラインプロジェクトの他、複数プロジェクトを同時進行中

メタバース向けスマートグラス 例



IJPシステム

光学製品精密加工システム

予想市場規模

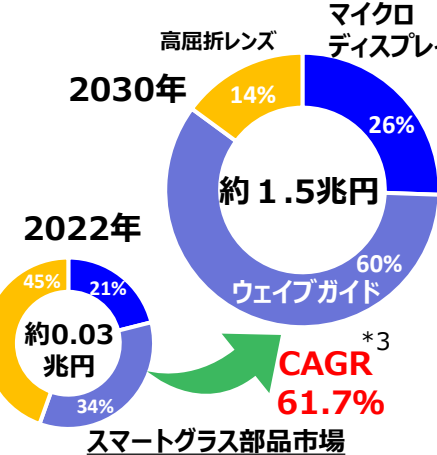
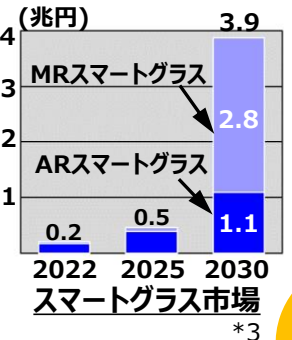


マイクロディスプレイ一括封止ライン

インクジェット装置

ナノインプリント装置

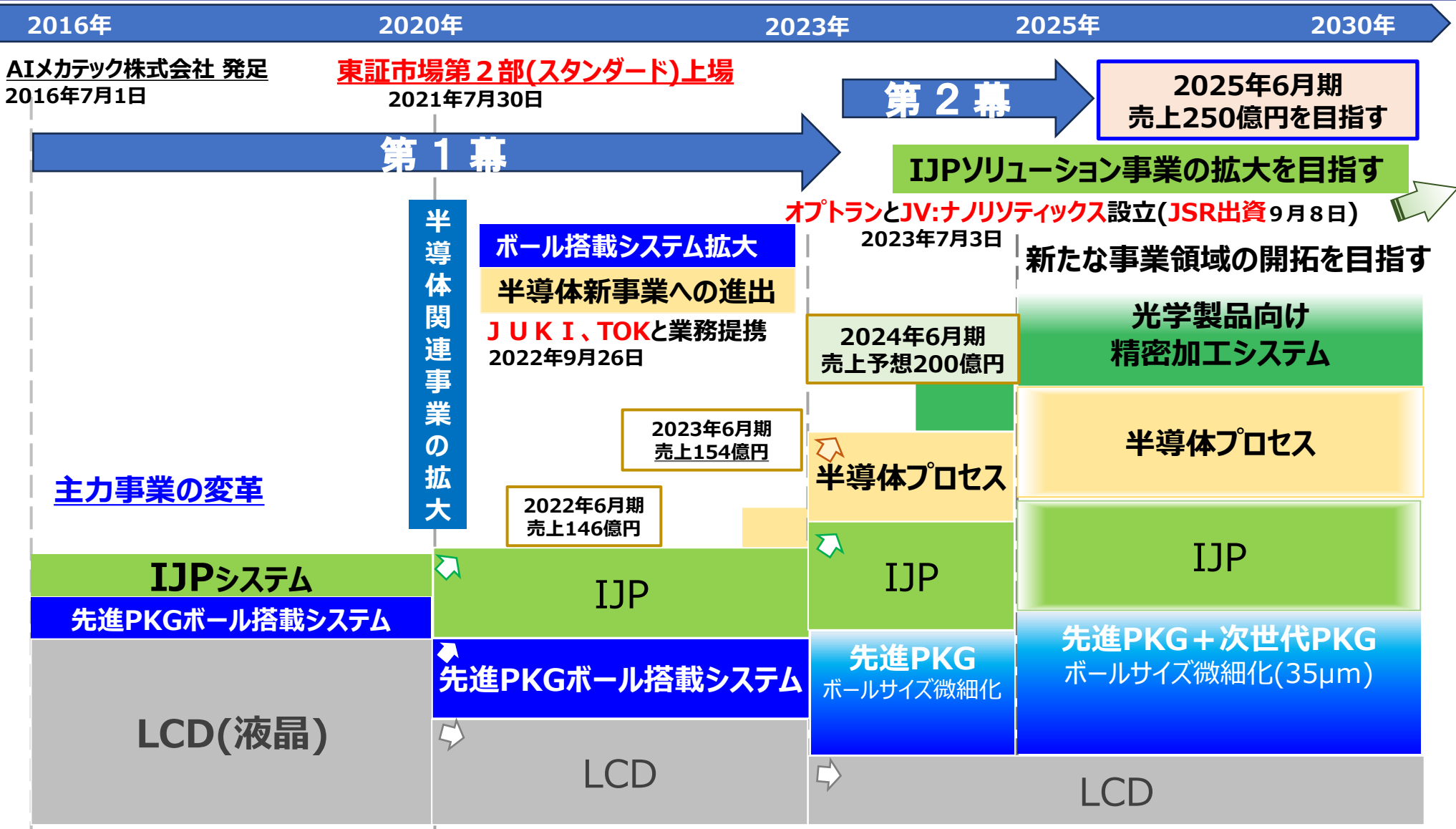
蒸着薄膜形成装置



出所：*1 DigiLens Inc *2 TechnoBeast <https://youtu.be/WpbP3dY1EHI> *3 富士キメラ総研

中長期的な成長イメージ

主力事業の変革：AIメカテックの持続的な成長に向け事業構造改革を積極的に進行中



2. ファイナンス概要

今後の成長戦略実現に向けての調達

【目的】

①収益性の高い「半導体関連 と IJPソリューション」事業の生産能力拡大(40%増加)

- 生成 A I 用半導体向けウェハハンドリングシステム、パワー半導体向けプラズマ・UV装置需要（半導体関連事業）
 - スマートグラス向けマイクロディスプレイ括封止ライン、光学製品向け精密加工システム需要（IJPソリューション事業）
- 両事業における生産・検査・評価能力拡大のため、「装置組立用建屋」、「クリーンルーム」を増設

②両事業における顧客からの旺盛な引き合いに対応

- 2024年6月期第2四半期末受注残は258億円（前年同期末比62%増）まで拡大。将来的な受注に繋がる顧客からの引き合いも旺盛
- 運転資金の増加も想定

③財務体質の強化と更なる成長への投資

- 過去の半導体に対する需要変動の大きさを考慮し、資本調達により財務体質を強化
- 同時に、収益性の高い事業への資金投下によって、中期的なROE指標の拡大を企図

【資金用途】

No	具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
1	設備投資（装置組立用建屋、クリーンルーム等）	2,000	2024年7月～ 2025年12月
2	運転資金（半導体関連事業等における部品及び材料調達、外注費等）	689	2024年4月～ 2026年3月
合計		2,689	-

新株予約権発行による資金調達の実施 行使価額修正条項付第3回新株予約権（停止指定条項付）

		行使価額修正条項付第3回新株予約権（停止指定条項付）
割当予定先		みずほ証券
調達想定額		約2,689百万円（当初行使価額ベース、差引手取概算額）
新株予約権の個数		6,530個
潜在株式数/希薄化率		潜在株式数653,000株（議決権6,530個相当） / 潜在希薄化率（対総議決権数）11.63% （2023年12月末日時点の総議決権数56,137個に対して）
行使可能期間		2年（2024年3月8日～2026年3月9日）
行使価額	当初	4,121円（発行決議日の直前取引日(2024年2月19日)の終値である4,480円の92%）
	上限	なし
	下限	3,136円（発行決議日の直前取引日(2024年2月19日)の終値の70%）
	行使価額の修正	各行使請求日の直前取引日の終値の92%（但し、下限行使価額は下回らない）
停止指定条項		当社は2024年3月11日から2025年9月9日までの期間中、割当先に対して行使ができない期間を指定することが可能
当社による任意取得		2週間以上前の事前通知により、当社は残存する本新株予約権を発行価額と同額で取得することが可能

注： 詳細は、本日公表のプレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権（停止指定条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

「既存株主の皆様の利益に十分配慮し、さらなる成長に向けた資金を確保」

①過度な希薄化への配慮

- 発行後の当社株価動向に関わらず、本新株予約権の行使による最大増加株式数が固定されていることから、株式価値の希薄化が限定（潜在株式数653,000株/潜在希薄化率11.63%）
- この点で、行使価額が下方修正されると潜在株式数が増加する転換社債型新株予約権付社債（一般的なMSCB）とは異なる

②株価への影響に対する配慮

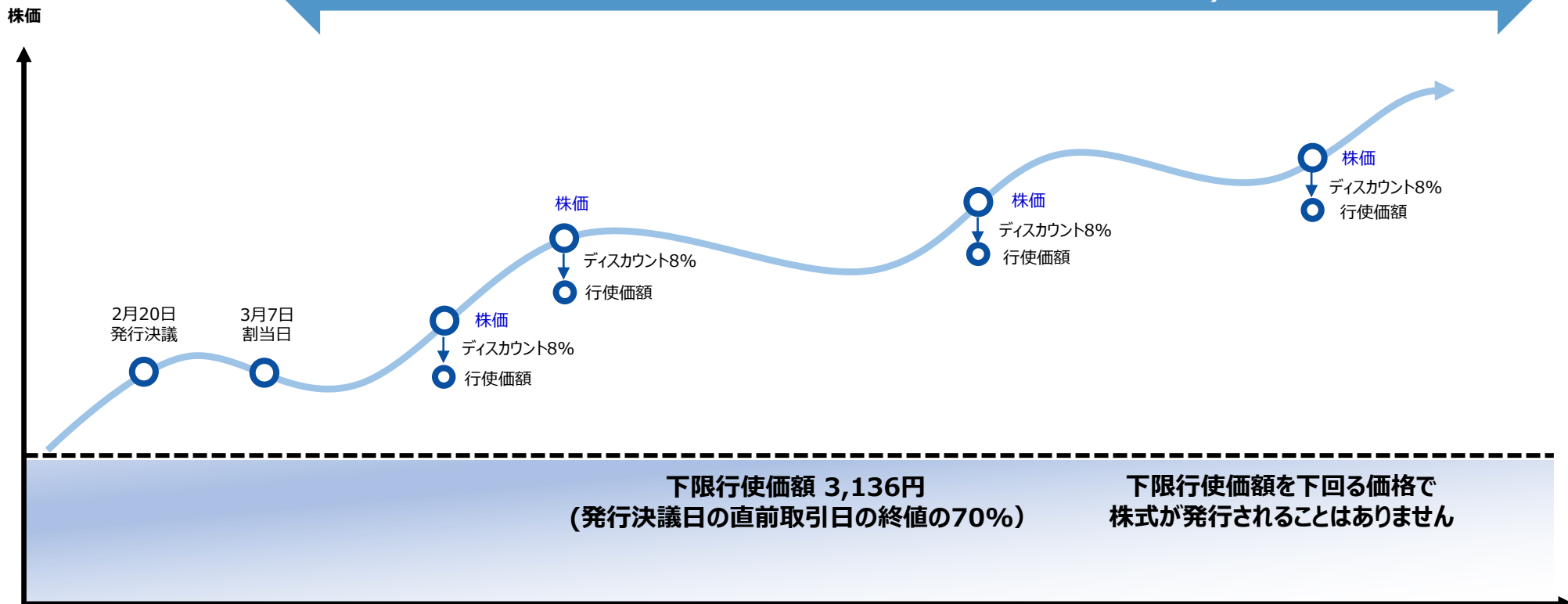
- 修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはなく、株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面において、さらなる株価低迷を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように配慮した設計
- 停止指定条項が付与されており、当社株価動向等を勘案して、当社が割当予定先であるみずほ証券による本新株予約権の行使を希望しない場合は、停止指定期間を指定することが可能

③資本政策の柔軟性の確保

- 資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により残存する本新株予約権の全部を取得することが可能

株価動向を見極めながら行使をコントロール可能

- 行使価額は行使請求の直前取引日の終値の92%に相当する金額に修正されます
- 修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはありません
- 今後の株価動向により、当初資金調達総額を調達できない場合があります
- 当社の判断により、割当予定先であるみずほ証券が行使できない期間を指定することが可能です



注： 上記はイメージであり、当社株価が上記の通り推移することを約束するものではありません

時間軸

- IR情報に関するお問い合わせ先

【IR窓口】

AIメカテック株式会社 経営企画部

TEL : 0297-62-9111

URL : <https://www.ai-mech.com/>

－ 注意事項 －

本資料は、当社の第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権（停止指定条項付）の発行に関する情報提供を目的としたものであり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為を目的とするものではありません。

本資料で記述されている当社の計画、戦略、判断等の将来に関する内容は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、経済情勢、景気動向、為替変動、事業環境等の様々な要因の変化により、実際の業績等は本資料に記述されている内容とは大きく異なる可能性があります。

将来に関する記載について、当社はいかなる表明や保証をするものではなく、またこれを更新する義務を負いません。投資を行う際には、必ず投資家ご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。



“Create the Next by **A**dvanced and **I**nnovative Technologies”